



# 検査&ものづくりイノベーション研究会 2022年度公開研究会

## 『BGA搭載基板の品質不良検査とコスト削減』 ～「ムリ・ムラ・ムダ」のない検査に向けて～

### ◆公開研究会のご案内

日本の製造業は、1980年代後半から中国を中心に、コスト削減を軸とした海外への生産移管が行われ30年以上が経過しています。近年では、新型コロナウイルス感染症の影響や資源不足・人手不足などのリスクから、部品や人件費の高騰が経営環境にインパクトを与える一方で、グローバル化する企業の生産形態においても、「持続可能な開発目標」を掲げるSDGsという考え方が世界的に浸透し、生産活動の内容が多様化してきています。

こうした中で、実装基板及びベアボードの製造現場では品質を保証しつつ、検査にかかる費用の削減が経営面からも課題になっています。そのため、検査の立ち位置も、最小限の設備で複雑化した基板の不良検出のみにとどまらず、製造プロセスへの改善要求や、基板を含めた部品材料の選定への提案にまで幅を広げる必要が出てきています。

今回の公開研究会では、実装基板やベアボードの生産ラインで発生する、不良メカニズムに焦点を当て、品質を確保するために必要な視点（考え方）の持ち方や、品質不良発生防止へのアプローチについて、半田接合技術の掘り下げと、そこから見えてくる部品材料の選定にまで踏み込んでご紹介をいたします。また、基板実装における品質保証の原点を見つめ直すべく、「検査が提供する普遍的な価値」さらには、ハイブリット方式を活用した「3ム（ムリ・ムラ・ムダ）のない検査」についてもご紹介いたします。

**開催日時** 2023年2月3日（金） 13:00～15:15

**開催方式** オンライン開催(Zoom Webinarシステム利用)

**※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。**

13:00～13:05

開会の挨拶 幹事 阿部 伸之（日置電機株式会社）

13:05～13:20

検査技術委員会の紹介 委員長 内山 浩志（株式会社ニューリー・土山）（15分）

13:20～14:10

講演1：「BGA搭載の課題解決とあるべき姿

～ フリップチップ実装にみる信頼性確保技術と理想構造 ～」（50分）

秋田銀行 営業支援部 チーフアドバイザー（元TDK）

エレクトロニクス実装学会 エグゼグティブMフェロー 土門 孝彰 氏

14:10～14:40

講演2：「検査が提供する普遍的な価値とは」（30分）

日置電機株式会社 山崎 浩 氏

14:40～15:10

講演3：「ムリ・ムラ・ムダのない検査に向けて」（30分）

アンドールシステムサポート株式会社 谷口 正純 氏

15:10 ~

質疑応答、閉会の挨拶 主査 野口 健二 (テクノホライゾン株式会社)

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

## 参加要項

定員 100名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参加費(消費税込み)

正会員, 賛助会員の社員: 3,000円

名誉会員, 学生会員, 賛助会員(クーポン利用): 無料

非会員: 4,000円

## 注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されますと、**返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。
  - ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。  
(お支払い方法: 銀行振込・クレジットカード決済)
  - ③請求書や振込確認後の領収書のご発行は、返信メールのマイページから出力が可能です。
  - ④WEBの請求書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
  - ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで(複数口の場合は口数分)利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。※複数枚使用希望がある場合はお問い合わせください。
- \* キャンセルポリシー  
お申込み後のキャンセルはできません。

**下記から参加申し込みをお願いします。**

**会員/賛助/非会員の方**

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先

事務全般: 一般社団法人エレクトロニクス実装学会 E-mail: info¥jiep.or.jp

講演内容: 検査&ものづくりイノベーション研究会 主査 野口 健二 (テクノホライゾン株式会社)

E-mail: info-kensa¥jiep.or.jp

(メールアドレスは¥を@に置き換えてください)